

株 式 会 社 ブ イ ・ テ ク ノ ロ ジ ー

2 0 2 2 年 3 月 期 (第 2 5 期)

決 算 報 告 書

補 足 説 明 資 料

2022年5月16日

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. 2022年3月期決算報告 | P3~12 |
| 2. 2023年3月期 業績・配当の予想 | P13~14 |
| 3. 今後の展望 -さらなる成長を目指して- | P15~23 |

1. 2022年3月期決算報告

連結業績

- ▶ **前期比 減収減益（親会社株主に帰属する当期純利益は増益）**
 - ・ コロナ感染再拡大に伴う、顧客との共同評価遅れ・部材納期遅延・顧客都合による納期変更等により減収減益
- ▶ **直近予想比 減収増益**
 - ・ 売上は、中国ゼロコロナ政策による影響で、Q4案件の一部が延伸し微減
 - ・ 利益は、コストダウン・為替差益・海外関連会社の完全子会社化等の結果、営業利益以降の項目で改善

(百万円)	2021年3月期		2022年3月期				
	金額	構成比	業績予想 (21年11月)	実績			
				金額	構成比	増減率	
						前期比	業績予想比
売上高	55,186	100.0%	53,000	51,418	100.0%	▲6.8%	▲3.0%
売上総利益	15,704	28.5%	—	15,486	30.1%	▲1.4%	—
営業利益	6,604	12.0%	5,000	5,461	10.6%	▲17.3%	+9.2%
経常利益	6,836	12.4%	4,900	5,868	11.4%	▲14.2%	+19.8%
親会社株主に帰属 する当期純利益	3,513	6.4%	3,750	4,198	8.2%	+19.5%	+11.9%

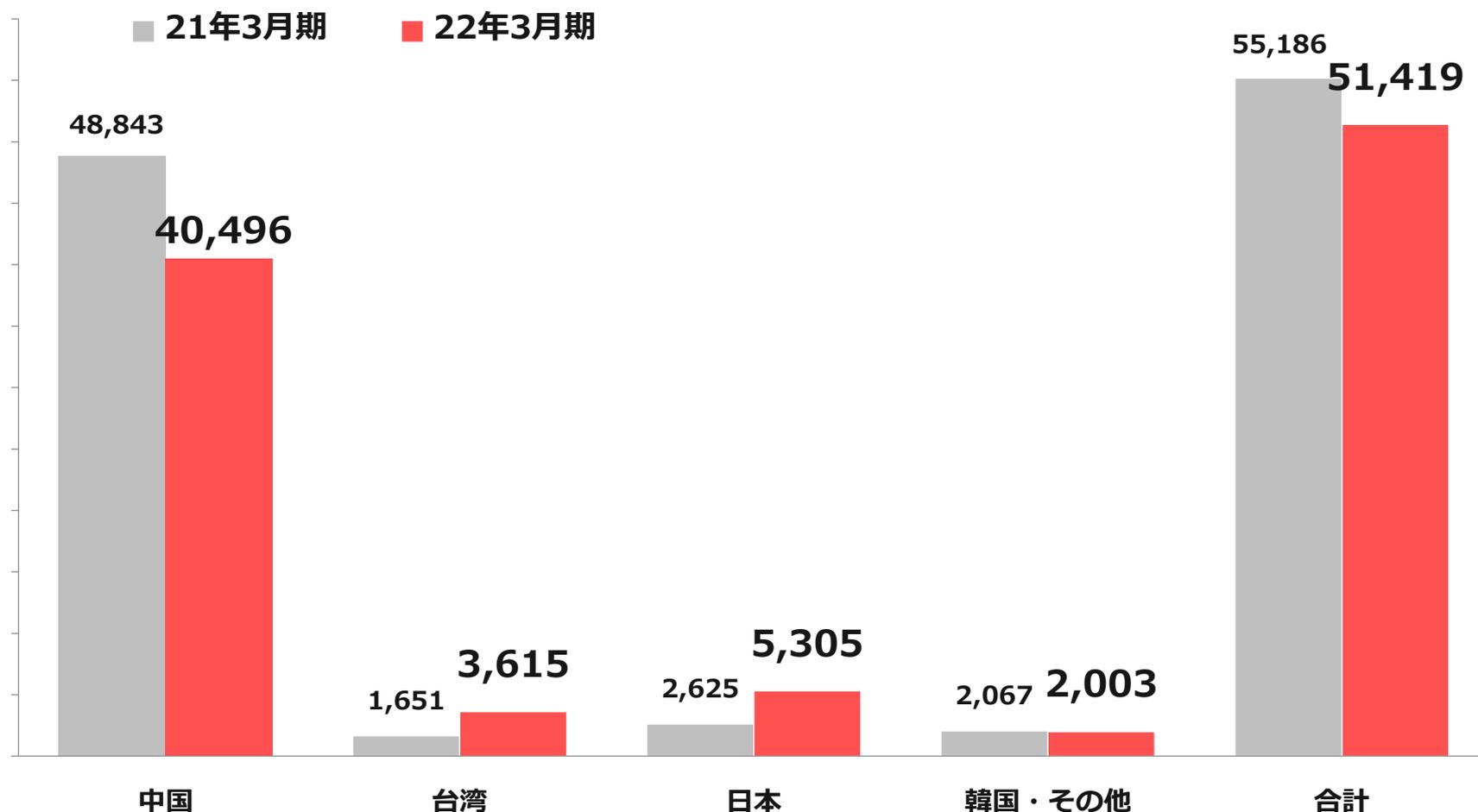
連結業績(セグメント情報)

▶ 半導体事業の売上・利益の構成比が上昇

セグメント情報 (金額単位：百万円)		21年3月期	2022年3月期		
		金額	金額	前年比増減 (▲は減少)	補足
半導体事業	売上高	2,241	7,679	+5,438	<子会社のNSS、LTJ、OHT 及びVテクの半導体関連事業で構成> ・ NSS、LTJが躍進(売上・利益とも) 半導体不足を背景としたSiウエハ新工場の設備投資、既存工場の生産能力増強投資等 ・ 利益率はこのれん償却影響除けば約11%
	構成比	4.1%	14.9%	+10.9%	
	営業利益	2	553	+551	
	構成比	0.0%	10.1%	+10.1%	
	利益率	0.1%	7.2%	+7.1%	
FPD事業	売上高	52,941	43,375	▲9,566	<Vテク及びOHTのFPD関連事業、蒸着マスク 事業、サルベージ等で構成> ・ 中国でのコロナ感染再拡大やゼロコロナ政策、 中国内大型FPD投資減の影響等で減収減益
	構成比	95.9%	84.4%	▲11.5%	
	営業利益	6,752	5,103	▲1,649	
	構成比	102.2%	93.4%	▲8.8%	
	利益率	12.8%	11.8%	▲1.0%	
その他	売上高	3	363	+360	<有機EL照明事業(Lumiotec)、農業等で構成>
	営業損失	▲151	▲194	▲43	
	利益率	—	—	—	
連結	売上高	55,186	51,418	▲3,768	略称補足 NSS:(株)ナノシステムソリューションズ LTJ:(株)リソテックジャパン OHT:オー・エイチ・ティー(株)
	営業利益	6,604	5,461	▲1,143	
	利益率	12.0%	10.6%	▲1.3%	

(参考) 地域別連結売上高 (単位：百万円)

- ▶ 22年3月期 中国向け売上高比率：79% (21年3月期：89%)
コロナ感染再拡大・ゼロコロナ政策・大型FPD新工場投資の一巡等から中国向けが減少

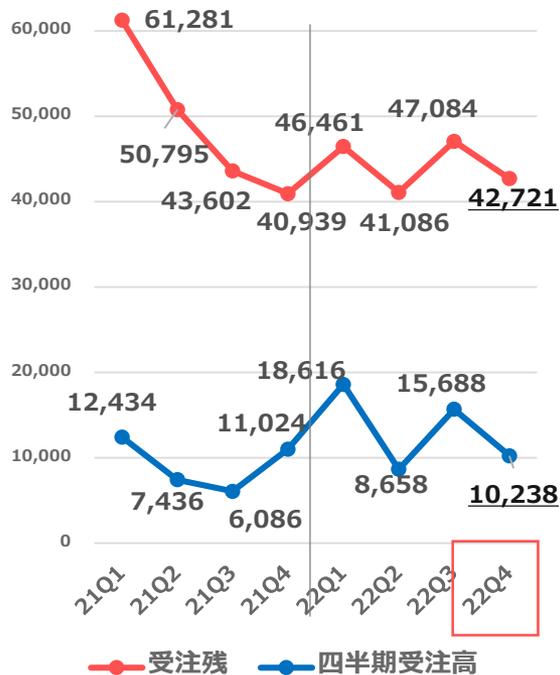


連結受注高・受注残の状況 (単位：百万円)

- ▶ 受注高：連結は、前期比+44%(年度受注高：532億円)
半導体関連は、前期比+64%(年度受注高：91億円)
- ▶ 受注残：連結は、前期比+4.4%の427億円
半導体関連は、前期比+22.1%の66億円

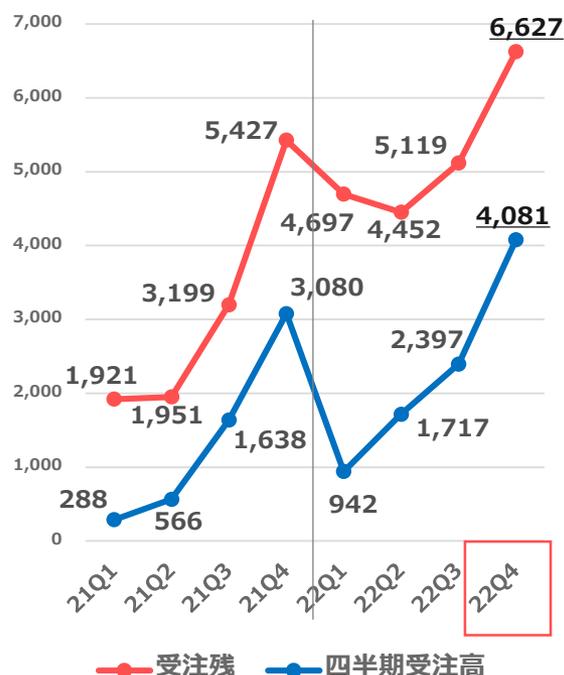
連結

	21年Q4	22年Q4	YoY
受注(12カ月)	36,980	53,200	+43.9%
受注残	40,939	42,721	+4.4%



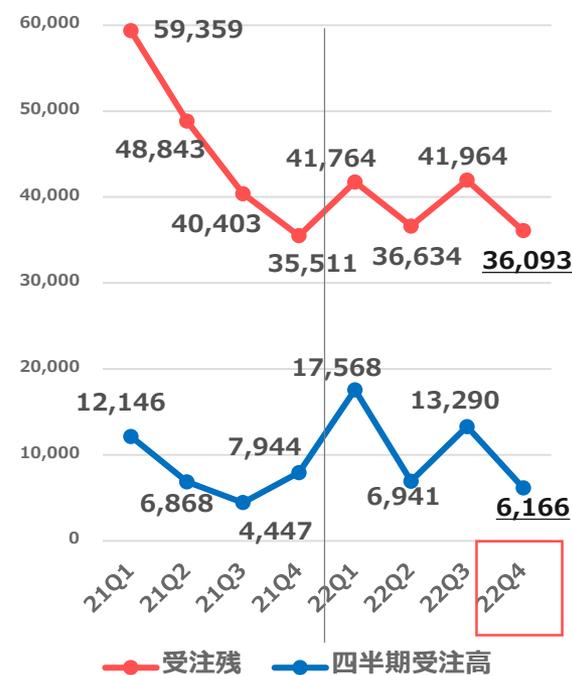
半導体関連

	21年Q4	22年Q4	YoY
受注(12カ月)	5,572	9,137	+64.0%
受注残	5,427	6,627	+22.1%



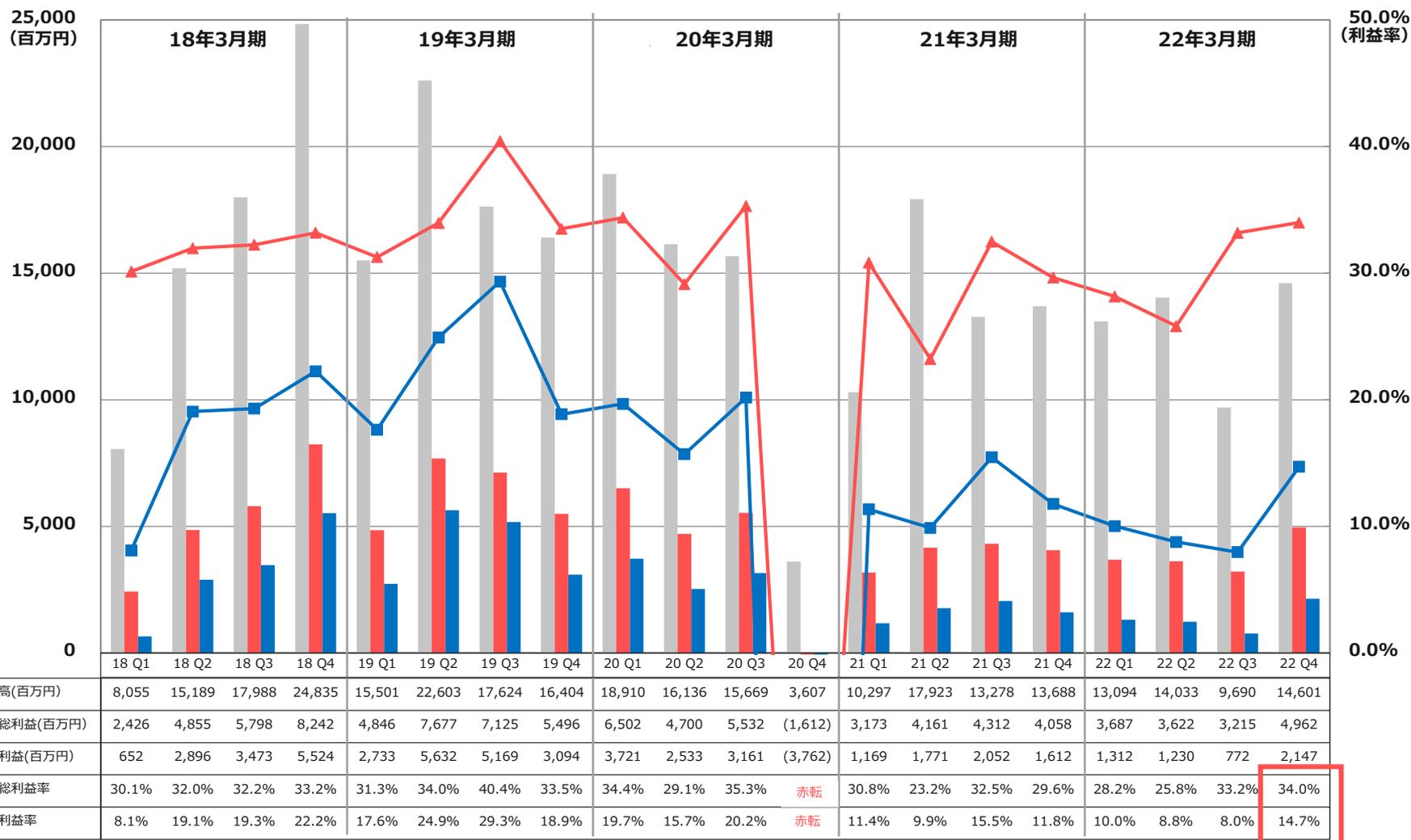
FPD

	21年Q4	22年Q4	YoY
受注(12カ月)	31,405	43,965	+40.0%
受注残	35,511	36,093	+1.6%



四半期毎連結売上高・利益の推移

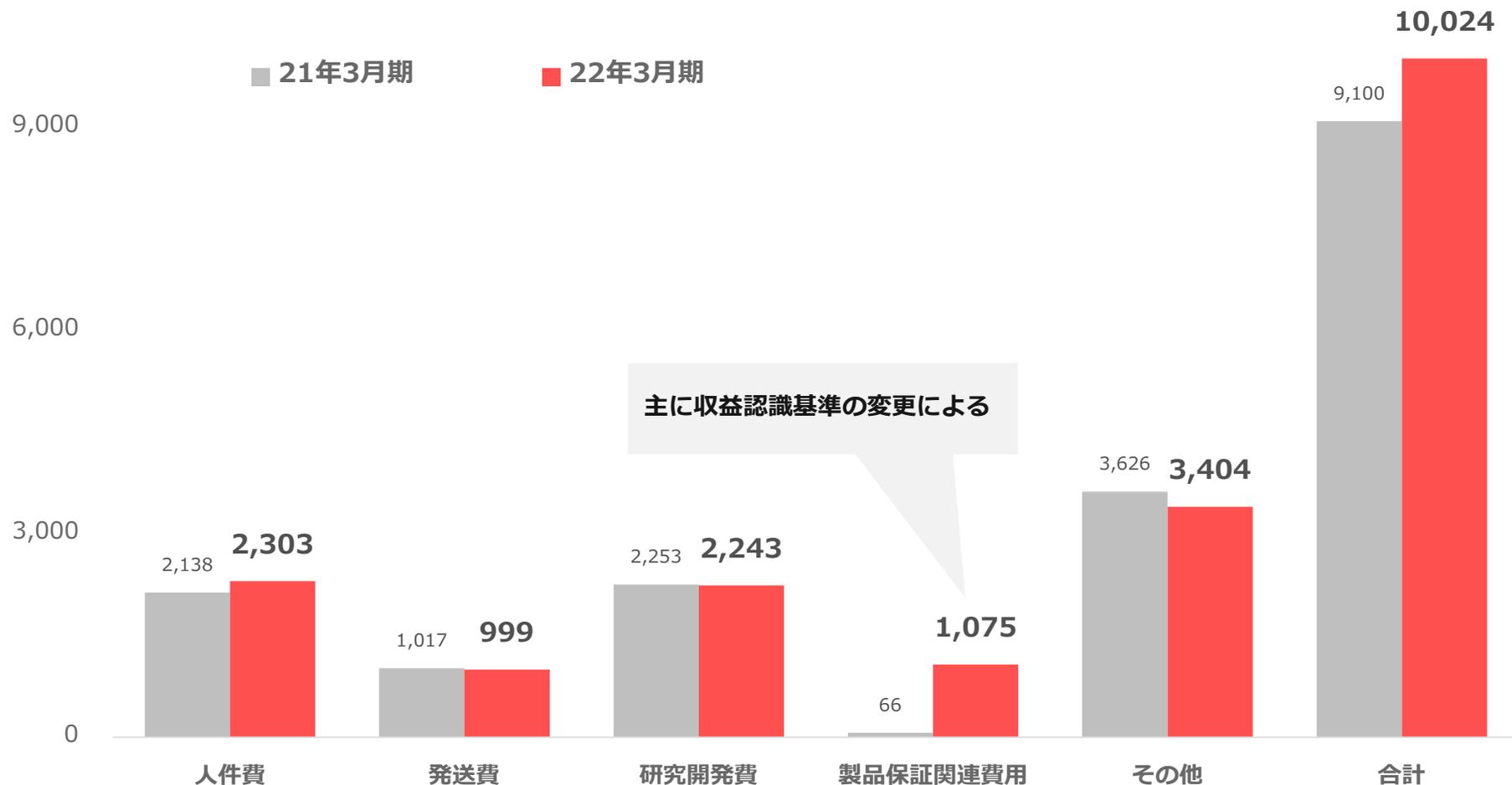
▶ プロダクトミックス、販売先の変化、コストダウンにより、Q4利益率は改善



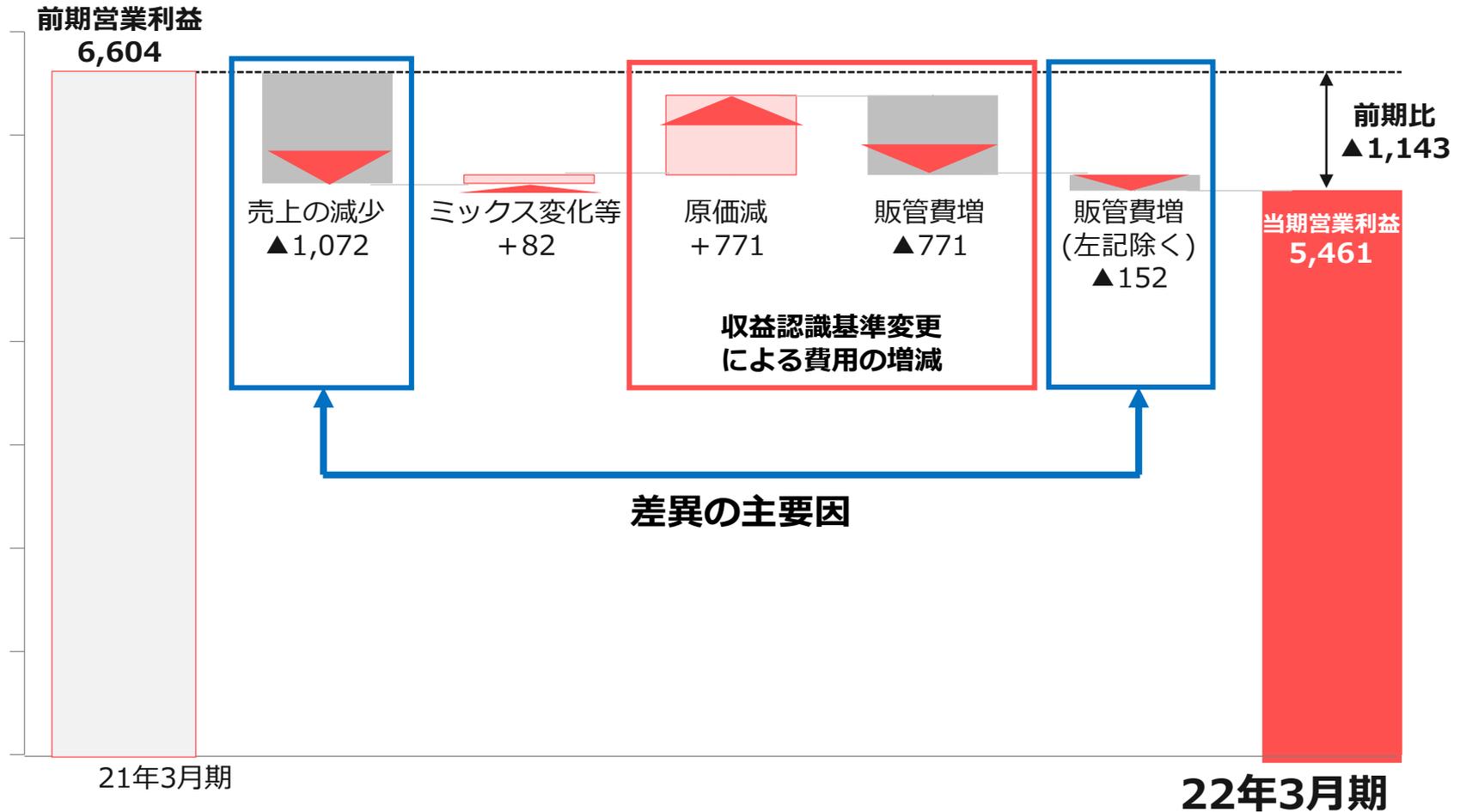
販売費及び一般管理費

(単位：百万円)

- ▶ **販管費：製品保証関連費用の増加等により、前期比+924百万円**
製品保証関連費用：前期比+1,009百万円
(内、収益認識基準変更によるもの：+771百万円)



(参考) 連結営業利益の差異分析 (単位: 百万円)

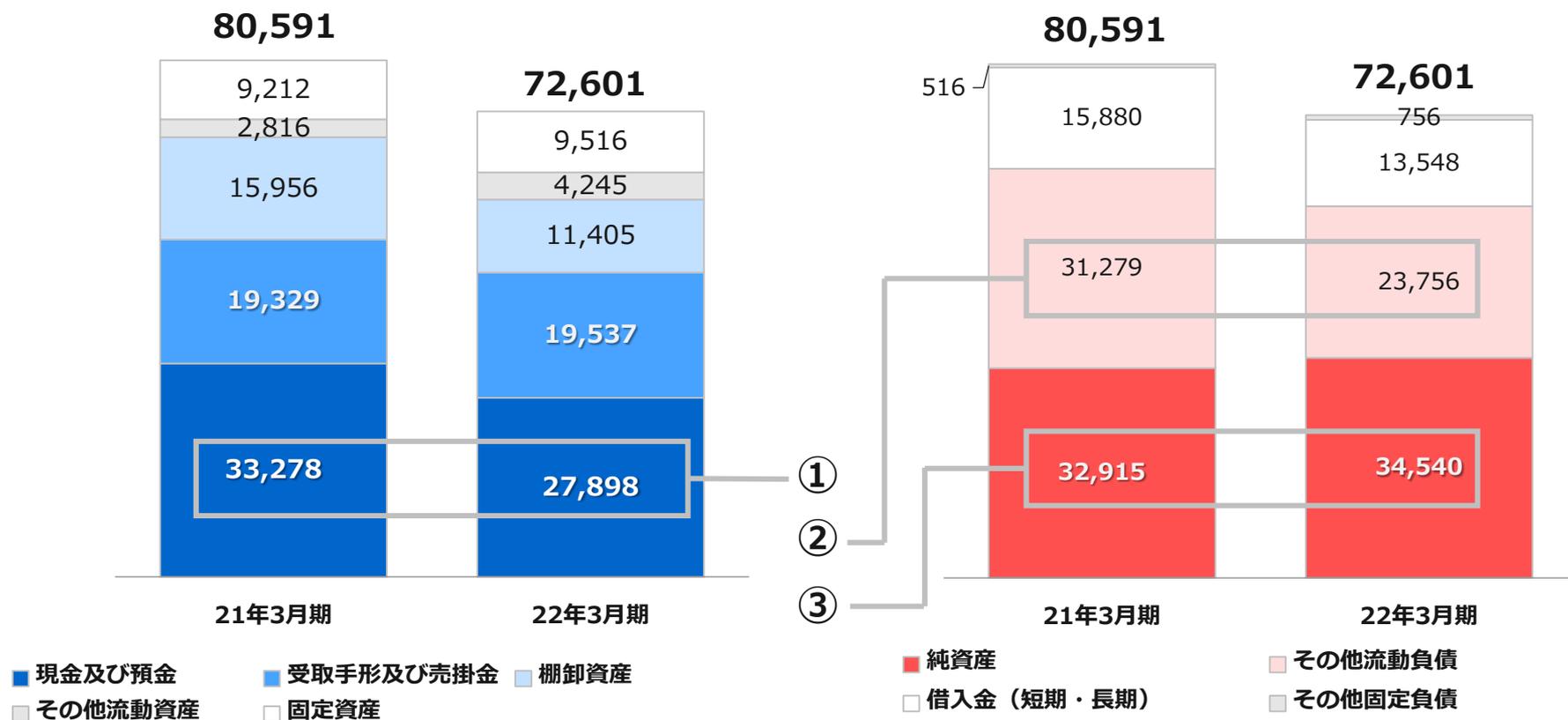


連結貸借対照表の推移 (単位：百万円)

- ① 現預金▲5,380百万円 : 主に借入金返済、YRP投資、株式取得(M&A)
- ② その他流動負債▲7,523百万円 : 主に前受金の減少
- ③ 純資産+1,625百万円 : 主に利益剰余金の増加

総資産

負債・純資産



連結キャッシュフロー

- ▶ 営業CF：純利益、棚卸資産減少、前受金の減少等により+1,408百万円
- ▶ 投資CF：有形固定資産の取得、株式の取得(M&A)等により▲1,554百万円
- ▶ 財務CF：借入金の返済、関連会社完全子会社化に伴う支払等により▲5,839百万円

金額単位：百万円		21年3月期	22年3月期
営業活動による キャッシュフロー	税金調整前純利益	7,054	6,450
	売上債権（増加▲）	5,507	▲364
	棚卸資産（増加▲）	9,021	5,139
	仕入債務（減少▲）	▲1,384	542
	前受金	▲3,308	▲7,352
	その他	3,283	▲3,007
	Total	20,173	1,408
投資活動によるキャッシュフロー Total		▲1,251	▲1,554
財務活動による キャッシュフロー	借入による収入	14,532	520
	返済による支出	▲10,997	▲3,269
	その他	▲1,563	▲3,090
	Total	1,972	▲5,839
現金及び現金同等物に関わる換算差額		283	605
現金及び現金同等物の増減額（減少▲）		21,177	▲5,380
期首現金及び現金同等物残高		11,981	33,158
現金及び現金同等物の期末残高		33,158	27,778

2. 2023年3月期 業績・配当の予想

2023年3月期の業績および配当の予想

- ▶ 今期案件の一部について、中国ゼロコロナ政策の影響を勘案
- ▶ 今後も中国コロナウィルス感染状況・顧客動向等を注視し、予想の精査を継続

連結業績予想	22年3月期(実績)		23年3月期予想		前期比 増減率
	金額(百万円)	構成比	金額(百万円)	構成比	
売上高	51,418	—	45,000	—	▲12.5%
営業利益	5,461	10.6%	4,500	10.0%	▲17.6%
経常利益	5,868	11.4%	4,400	9.8%	▲25.0%
親会社株主に 帰属する当期純利益	4,198	8.2%	2,900	6.4%	▲30.9%
EPS	434.21円		299.92円		—

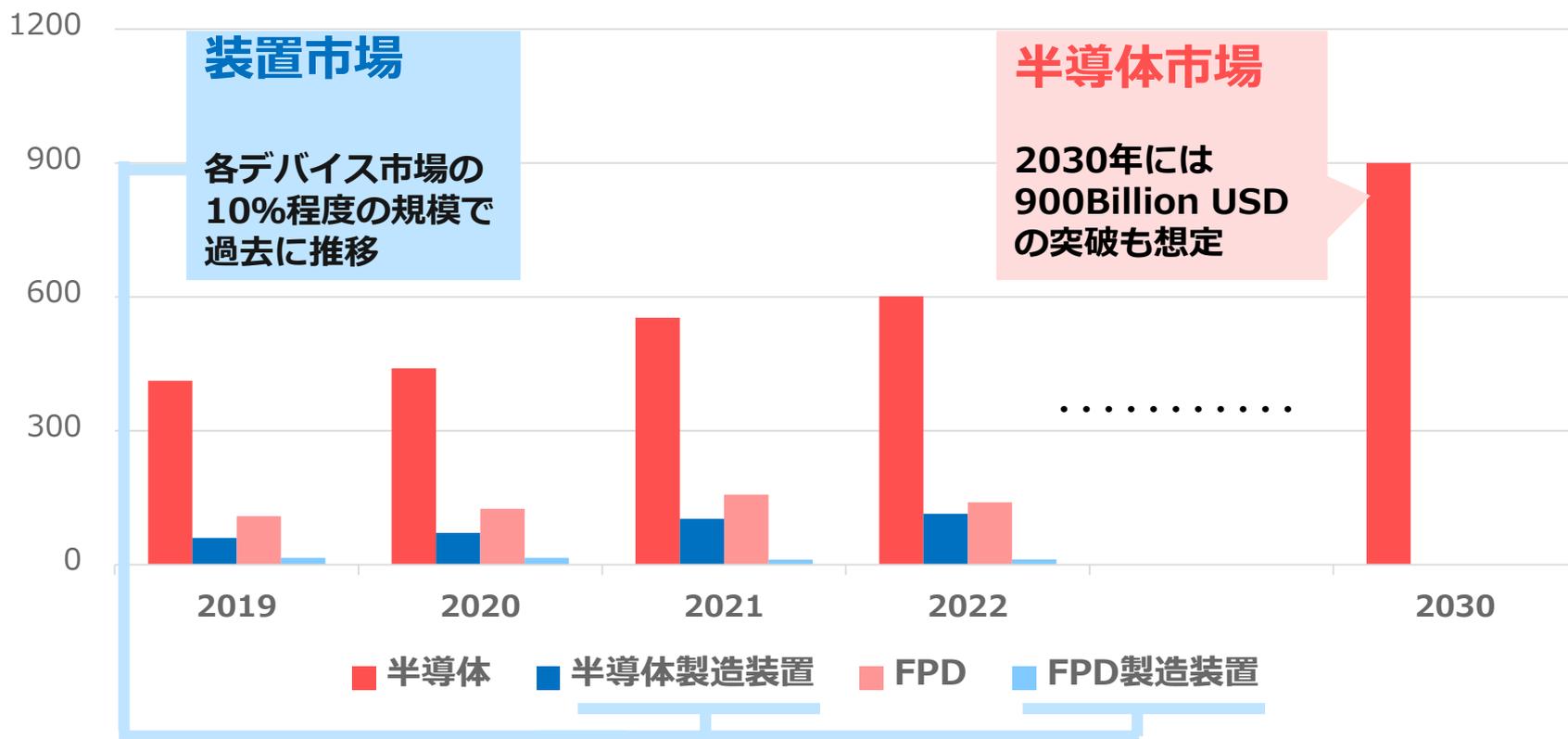
配当の状況	22年3月期	23年3月期
中間	60円(実績)	60円(予想)
期末	60円(計画)	60円(予想)

3. 今後の展望

— 更なる成長を目指して

半導体・FPD市場動向

- ▶ 半導体・FPD市場は、技術進化と社会のデジタル化の進展で成長が続く
 - FPD・半導体は、情報・通信、車載、エネルギー、情報インターフェイス等、産業の基盤



半導体・FPD関連市場推移

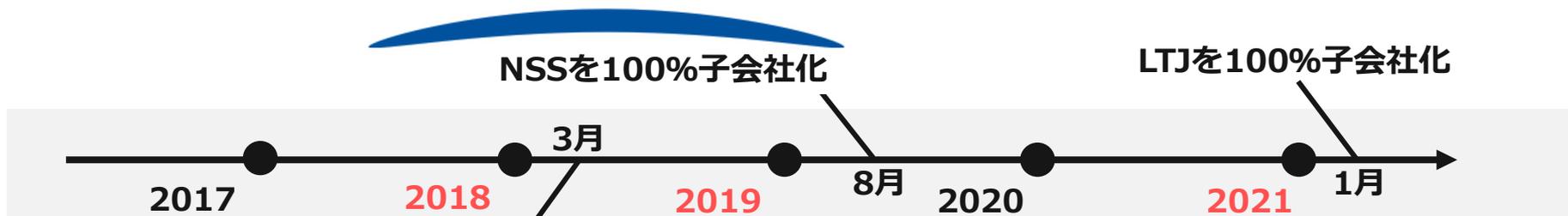
(2021年/Billion USD/ WSTI、SEMI、OMDIA各社、経産省等の予測資料より当社にて作成)

収益構造の変革

- ▶ 2018年より半導体関連事業本格化
 - ビジネスネットワークやM&Aを駆使し、短い期間で事業を強化

Nano
System Solutions

LTJ リソテックジャパン株式会社
Litho Tech Japan

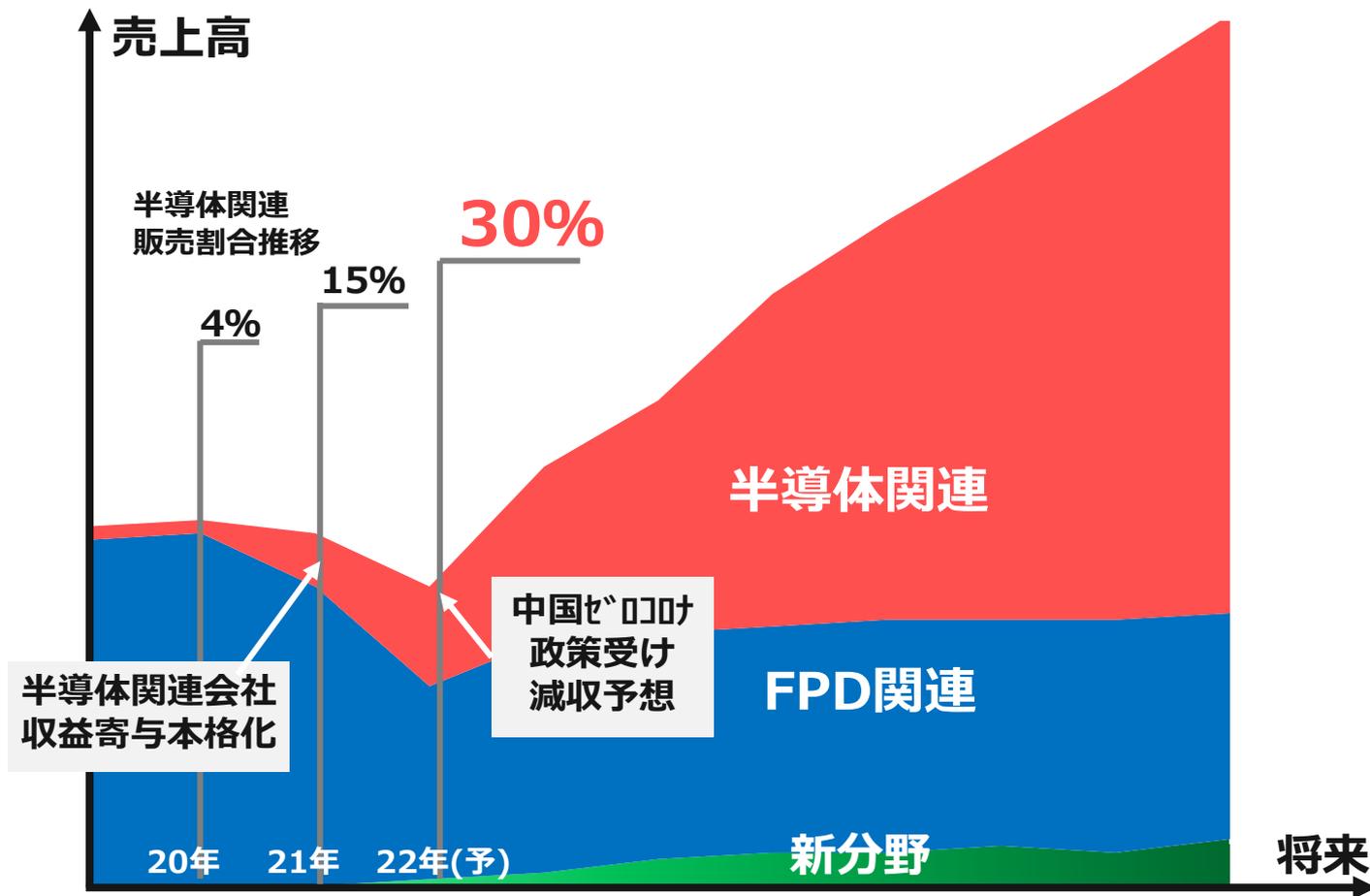


浙江芯晖装备技术有限公司

Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co.,Ltd

収益構造の変革

- ▶ 成長分野で新事業・新製品を立ち上げ、グループの持続的な成長の実現
 - ▶ 半導体関連事業成長の促進
 - ▶ 収益基盤としてのFPD関連事業の安定化
 - ▶ 社会課題解決型ビジネスへの挑戦(新分野参入)



シリコンウェーハ/フォトレジスト/ICテスター

- ▶ VTグループとのシナジーで子会社本来の強さを発揮
 - ▶ VTグループ加入後、NSS:子会社化後売上2.5倍/LTJ:子会社化後売上1.5倍に
- ▶ 子会社リソースのさらなる強化、新製品開発で販売拡大

子会社名	NSS	Z-CSET	リソテックジャパン
製品	ウェーハ検査 	研磨・研削 	メモリーテスター 
			コータ・デベロッパー 
対象市場	シリコンウェーハ		フォトレジスト

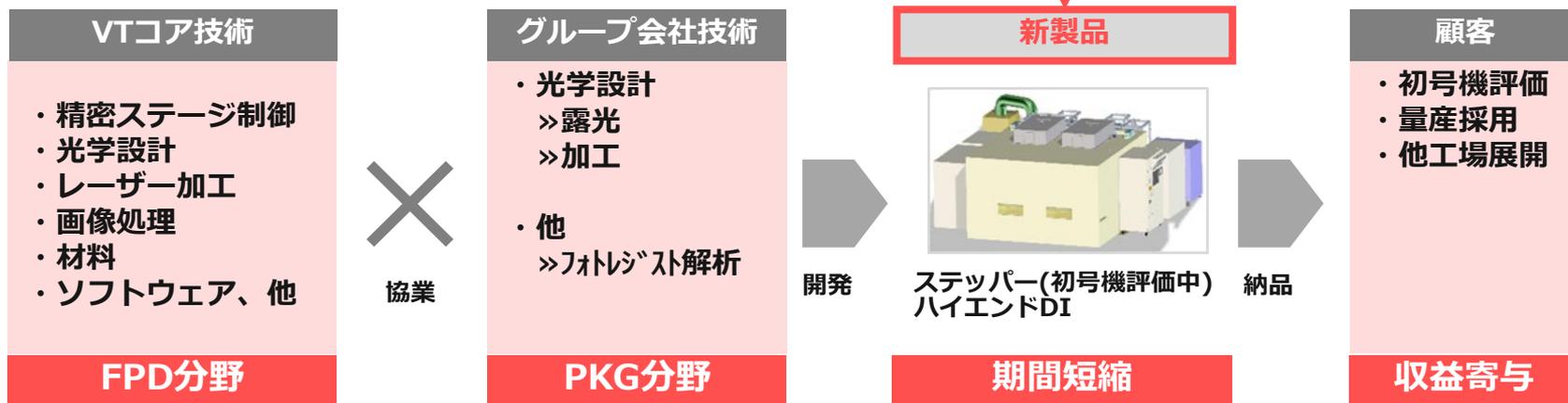
半導体関連	市場状況等	現在の製品・事業等	今後
シリコンウェーハ等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 半導体需要増を背景とした、工場新設など、生産能力増強投資の増加 ・ SiC/GaN市場拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検査装置(高シェア) ・ 国内外需要増 ・ 研磨/研削 ・ 納入実績増 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生産等リソースをM&Aも活用し強化 ・ イノベーションセンター(YRP)投資 ・ 他用途展開 ・ 中国顧客向け拡販
フォトレジスト	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中国半導体産業育成(非最先端分野) ・ 材料開発活発化(国内) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ コータ・デベロッパー ・ フォトレジスト分析 	<ul style="list-style-type: none"> ・ リソース強化/増加する需要の取込み ・ 中国顧客向け拡販(中国販社活用) ・ 増加する国内需要の取込
ICテスター	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中国半導体産業育成 	<ul style="list-style-type: none"> ・ メモリー用 ・ イノテック社と協業 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中国顧客向けに拡販(Z-CSET) ・ 他用途の開拓検討

フォトマスク/半導体パッケージ

- ▶ VTコア技術と、グループ会社の技術および事業とのシナジーで、新製品を本格投入し、収益拡大を狙う

半導体関連	市場状況等	現在の製品・事業等	今後
フォトマスク (レガシー半導体)	<ul style="list-style-type: none"> ・設備更新投資の増加 ・中国レガシー投資拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ・欠陥修正・検査 ・レジストレーション 	<ul style="list-style-type: none"> ・高精度版の市場投入 ・検査装置の開発
		マスクライター	高精度マスクへの対応
半導体パッケージ	<ul style="list-style-type: none"> ・微細化 ・部品需要増 ・設備投資増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・露光 <ul style="list-style-type: none"> ➢ ステッパー(評価機) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ステッパー(量産機) ・ハイエンドDI
		Open/Short検査	<ul style="list-style-type: none"> ・EPISセンサー(回路電流可視化)

VTコア技術とグループ会社技術・事業領域とのシナジー

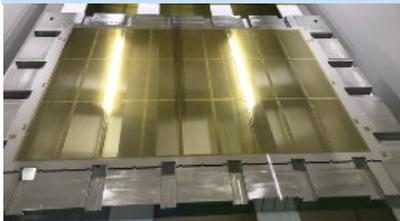


OLED/MiniLED/μLED/LCD

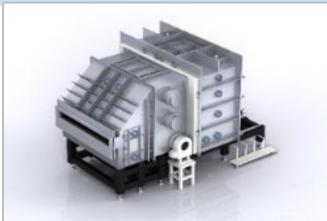
- ▶ OLED/MiniLED/μLED関連装置：開発進展と採用拡大
- ▶ LCD関連装置：他プロセスへの採用拡大/差別化

FPD	市場状況等	現在の製品・事業等	今後
OLED	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中型、大型用途の投資増 ・ 中国ゼロコロナ政策 	蒸着マスク	量産採用/マスクの大型基板対応
		蒸着装置	評価パートナー/評価機導入
		レーザーアニール	
		サルベージ	デムラIP新規採用拡大(ICメーカー)
MiniLED μLED	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次世代LCDバックライト開発 ・ 大型パネル開発 	LLO/移載	タクト・歩留まり改善機の投入
		修正	検査技術の開発
		レーザーアニール ・ パネル試作に成功	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中国顧客等に拡販 ・ 次世代バックライト・大型ディスプレイ ・ 試作機の正式受注
LCD	安定的に推移	露光・検査 中国ゼロコロナ政策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他プロセスへの採用拡大/差別化 ・ 左記政策で今期売上は前年比減を予想

OLED



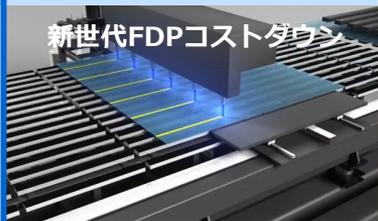
蒸着マスク



蒸着装置(開発機)

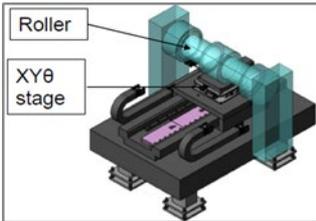
Backplane

新世代FDPコストダウン



レーザーアニール(BLDA)

Backplane



移載装置

LLO(Laser Lift Off)

修正
検査

μLED/MiniLED

レーザーアニール技術(BLDA)について

- ▶ **OLEDや μ LEDの大型化・高精細化・フレキシブル化の課題**
TFT基板(バックプレーン)の低コスト化と電気的な特性の改善(電子移動度、OFF電流等)の両立

▶ **BLDA(青色半導体レーザーアニール)の特長**

- ① LTPSやIGZOと比較して、優れた電気特性を実現可能
- ② ELAより高い電子移動度
- ③ 局所的(選択的)アニールで下地(Cu配線など)へのダメージ低減
- ④ Top-GateとBottom-Gateに対応
- ⑤ 低ランニングコスト/1年以上メンテナンスフリー
- ⑥ 基板サイズはG2~G10.5までフレキシブルに対応可能

Comparison of the technology for high electric mobility

		OLED TV	a-Si	BLDA
要求仕様 (電気特性面)	Mobility (cm ² /VS)	>10	0.5	70-500
	Ion/Ioff	>10 ⁷	10 ⁶	10⁷
	Vds(@3uA)	<5V	-	5-7V
	S-factor (V/decades)	0.5		0.2V
製造容易性		-	easy	easy
安定性	Life time	-	poor	good

新分野

- ▶ 中長期の持続的なグループの成長には、海外市場中心の電子デバイス製造分野と異なる事業領域で、国内市場をターゲットとした事業の立上げが不可欠

農業(ブランドトマト栽培)

現在

- ・アイメック®農法
- ・ブランド名「陽香」
- ・蘇州にて栽培
- ・高糖度/高栄養価(リコピン他)
- ・中国ECで販売中



陽香

今後

- ・国内栽培
- ・農業経験を活用した技術開発、他



蘇州市農場



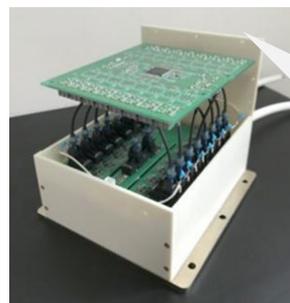
脱炭素(SiC技術への投資)

現在

- ・ネクスファイ・テクノロジー社へ資本参加
- ・2021年6月設立
- ・SiCデバイスを用いた高圧電源技術に強み
- ・国プロ支援/当社他VCにて出資

今後

- ・インフラ、遠距離送電用途開拓(高圧直流送電)
- ・半導体/FPD製造装置等の専用機用途開拓
- ・EV/モーター検査関連用途開拓



高電圧高速
スイッチングモジュール

高エネルギー
研究所の
加速器用に
採用



高圧直流電源

中性子線がん治療器
(BNTC)で
採用



V-TECHNOLOGY

お問い合わせ先

社長室IRグループ

vtj-mng-pre@vtec.co.jp



将来見通し等について

▶ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

▶ 為替リスク

当社の主力製品である、フラットパネルディスプレイ製造装置の輸出販売は、原則円建てで行われております。一部に外貨建て決済もありますが必要に応じて受注時に為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしております。従って、装置販売に関する為替レート変動による影響は軽微であります。

▶ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

▶ 会計方針の変更について

① 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を2022年3月期第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

② 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を2022年3月期第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

▶ 報告セグメントの変更等に関する事項

従来、量的基準より判断して、当社の報告セグメントは「FPD事業」のみとなるため、セグメント情報の記載を省略しておりましたが、2022年3月期第1四半期連結会計期間において、量的な重要性が増したため、報告セグメントを従来の単一セグメントから、「FPD事業」、「半導体関係事業」の2区分に変更し、報告セグメントに含まれない事業セグメントを「その他」としてセグメント情報を開示しております。なお、市場、顧客の種類及びサービスの内容が概ね類似している事業セグメントを集約しております。